

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯截至二零零九年六月三十日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（[中芯]或[本公司]）於今日公佈截至二零零九年六月三十日止三個月的綜合經營業績。
- 二零零九年第二季的總銷售額由二零零九年第一季的146,500,000元上升82.5%至267,400,000元，與二零零八年第二季相比下降22.0%，尤其是在二零零九年第二季來自於90納米及0.13微米節點的高端邏輯銷售額與上一季相比大幅增加135.3%。二零零九年第二季的毛利率由二零零九年第一季的-88.3%改善至-4.8%主要由於晶圓出貨量和產能利用率大幅增加所致。二零零九年第二季普通股持有人應佔虧損為98,100,000元，二零零九年第一季普通股持有人應佔虧損為178,300,000元。每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為0.2196元。
- 以下為本公司於二零零九年七月二十八日就截至二零零九年六月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條規定的披露責任於二零零九年七月二十八日作出本公佈。

以下為本公司於二零零九年七月二十八日就截至二零零九年六月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海—二零零九年七月二十八日—國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零九年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零零九年第二季概要

- 二零零九年第二季的總銷售額由二零零九年第一季的 146,500,000 元上升 82.5% 至 267,400,000 元，與二零零八年第二季相比下降 22.0%，尤其是在二零零九年第二季來自於 90 納米及 0.13 微米節點的高端邏輯銷售額與上一季相比大幅增加 135.3%。
- 二零零九年第二季的毛利率由二零零九年第一季的-88.3%改善至-4.8%主要由於晶圓出貨量和產能利用率大幅增加所致。
- 二零零九年第二季普通股持有人應佔虧損為 98,100,000 元，二零零九年第一季普通股持有人應佔虧損為 178,300,000 元。
- 每股美國預托股份淨虧損（攤薄）為 0.2196 元。

二零零九年第三季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 二零零九年第三季收入預期按季增加 14% 至 18%。
- 經營開支去除匯兌損益預期介於 90,000,000 元至 93,000,000 元之間。
- 資本支出預期介於 60,000,000 元至 65,000,000 元之間。
- 折舊及攤銷預期介於 199,000,000 元至 201,000,000 元之間

-
- 在評論該季度業績時，中芯國際首席執行官張汝京博士說：“在 2009 年第二季度，我們看到各個領域的業務均顯著復甦，總收入按季增長 82.5%，超過了我們最初的營收指引。由於邏輯出貨量按季度增長了 102%，我們的產能利用率於第二季度亦提升至 75%。其中，先進邏輯（0.13 微米及以下）收入比 2009 年第一季度增長超過 135%，而其佔總收入的比例則由第一季度的 32% 增加至第二季度的 41%。這顯著復甦主要來自我們通信和消費市場客戶的強勁表現。在過去連續 5 個月，我們的訂單出貨比率一直大於 1，而第二季度新流片的數目較今年第一季度增長 58.5%，達到六個季度以來創紀錄的高增長，這些都初步顯示持續復甦迹象。

第二季度的復甦是由所有地區客戶需求恢復和亞洲市場需求強勁所帶動。以區域來看，我們的大中華區收入在第二季度增加了 87.4%，而北美的收入則按季增加了 85.3%。我們亦看見歐洲地區於本季度錄得健康的銷售增長。

在先進技術發展方面，我們已經在第三季度開始了 65 納米低功耗的試產。此外，我們的 45 納米低功耗技術亦按計劃與多個正在開發產品的客戶進行認證，我們並預定於 2009 年第四季度通過完整的技術認證。此外，我們已經成功獲得 45 納米高性能工藝在首批完整流程晶片上的良率驗證，使我們能夠進一步為我們的客戶提供具有競爭力的先進技術服務。展望未來，我們相信不斷努力去加強我們的技術和全面的產品組合將有利於我們的盈利。

在這次的全球經濟周期性低迷時期，我們仍能保持正數的扣除息稅折舊攤銷前溢利利潤 (EBITDA margin)。我們亦正繼續嚴格控制資本支出及加強我們的財政狀況。截至 2009 年 6 月 30 日的六個月期間，我們投入了共四千四百九十萬美元資本支出，而於同期則產生了一億二千一百三十萬美元淨運營現金流。我們一億九千萬美元的年度資本支出預算將保持不變。在嚴格控制資本支出下，我們預計 2010 年的總折舊和攤銷費用將按年下降約 13 %。

在客戶訂單仍然強勁的情況下，我們看到目前季度收入的復甦勢頭將在第三季度繼續保持雙位數的按季增長。同時，我們厲行成本控制，而且繼續致力於加強產品組合，並努力強化在各個領域上的業務和財務表現，從而爭取我們實現盈利的目標。 ”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零九年七月二十九日

時間：上海時間上午八時

撥號及登入密碼：美國 1-617-614-3672(密碼：SMIC)/1-800-260-8140 或香港 852-3002-1672
(密碼：SMIC)

二零零九年第二季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981)，是世界領先的集成電路晶片代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶片代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45 納米晶片代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶片廠和三座 200mm 晶片廠。在北京建有兩座 300mm 晶片廠，在天津建有一座 200mm 晶片廠，在深圳有一座 200mm 晶片廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯代成都成芯半導體製造有限公司經營管理一座 200mm 晶片廠，也代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶片廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站<http://www.smics.com>

安全港聲明

(根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據 1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括持續的經濟復甦是否已經開始，中芯國際於 2009 年第四季度通過 45 納米低功耗完整的技術認證的計劃，中芯國際於加強技術和全面產品組合的能力，中芯國際在 2009 年的預期資本支出總額，中芯國際於 2010 年的總折舊和攤銷費用將比去年同期下降的預測，中芯國際於第三季度持續雙位數收入增長的復甦勢頭，以及在隨後“折舊和攤銷”，“資本概要”和“二零零九年第三季度指引”等陳述乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯國際於加強技術和全面產品組合的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、未決訴訟的命令或判決、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料，包括其於二零零九年六月二十二日以 20-F 表格形式呈交予證交會的年度報告，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件，包括 6-K 表格。其他未知或不可預知的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期(或如無有關日期，則為本新聞發佈日期)的情況而表述。除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

重大訴訟

台積電法律訴訟之近期發展

二零零六年八月二十五日，台積電入稟加州阿拉米達郡最高法院，指稱本公司違反和解協定、違反承兌票據及挪用商業機密而對本公司及若干附屬公司（即中芯上海、中芯北京及中芯美國）提出訴訟。台積電要求（其中包括）損害賠償、禁制令、律師費及提早支付和解協定所規定的餘下未付金額。

當前訴訟中，台積電指稱本公司利用台積電之商業機密製造本公司0.13微米或以下制程產品，又指稱由於本公司違約，台積電之專利特許權已終止，而有關本公司較大制程產品的不起訴契諾亦已失效。本公司強烈否認所有關於挪用機密的指控。法院並無證據證明台積電之申索有效。法院已定二零零九年九月八日再審訊。

本公司於二零零六年九月十三日公佈，除強烈抗辯台積電在美國訴訟的指控外，亦已於二零零六年九月十二日反訴台積電，就（其中包括）台積電違反合約及違反真實公平交易的推定契諾，要求台積電賠償損失。

中華人民共和國北京市高級人民法院於二零零六年十一月十六日受理本公司與本公司全資附屬公司中芯上海及中芯北京對台積電違反誠信原則、商業詆毀的不公平競爭行為提出的指控（「中國訴訟」）。在中國訴訟中，本公司要求（其中包括）判令台積電停止侵權行為、台積電向本公司公開道歉及賠償（包括台積電因侵權行為所獲利潤）。

二零零七年八月十四日，本公司修訂對台積電提出的反訴，要求（其中包括）台積電就違約及違反專利特許協定賠償。台積電隨後否認本公司經修訂反訴中的指控，並追加指控本公司向北京市高級人民法院起訴台積電乃違反和解協定。本公司否認台積電所追加的指控。

二零零七年八月十五日至十七日，加州法院就台積電申請臨時禁令禁止本公司的0.13微米邏輯晶圓制程採用若干加工技術進行聆訊。

二零零七年九月七日，法院拒絕台積電提出的臨時禁令申請，故此對本公司的業務發展及銷售並無影響。然而，法院要求本公司若計劃在若干情況下向非中芯國際機構披露邏輯晶圓技術時，須提前十天通知台積電，以便台積電可就該披露提出反對。

二零零八年五月，台積電就本公司的多項反訴向加州法院提交請求簡易判決的申請。本公司反對有關申請，而於二零零八年八月六日，法院決定部份批准並部份駁回台積電的申請。

二零零八年六月二十三日，本公司向加州法院反訴台積電，要求（其中包括）台積電就非法挪用中芯國際的商業機密以提升與中芯國際競爭的能力作出賠償。

二零零八年七月十日，加州法院就台積電申請臨時禁令禁止本公司向第三方披露有關0.30微

米邏輯晶圓制程的若干制程技術資料進行聆訊。二零零八年八月八日，法院批准台積電提出的部分申請，臨時禁制本公司披露十四個0.30微米制程步驟。二零零八年十月三日，中芯國際就法院於二零零八年八月八日的判令向加州上訴法院提出上訴，上訴有待審理。

預審時，中芯國際與台積電簽定的二零零五年和解協定的實際條款出現爭議。因此，加州法院在審訊前於二零零九年一月十三至十六日進行初審，純為厘定和解協定的條款及詮釋任何須「會面商討」的規定。二零零九年三月十日，法院發佈決定聲明，決定雙方於二零零五年一月三十日簽署協定，其後在台積電強烈要求下於二零零五年二月二日修訂。本公司相信法院的裁決是錯誤的，法院就此作出最終判決後或會遭中芯國際上訴。

二零零九年五月一日，本公司就台積電指控本公司違反承兌票據及違反加州的統一商業機密法提出簡易判決的申請，法院已於二零零九年七月十七日就此申請作聆訊，法院於二零零九年七月二十日駁回此申請。

加州法院其後安排於二零零九年九月八日開始審理有關台積電若干商業機密申索與中芯國際商業機密申索的全部責任事宜。

有關本公司於北京市高級人民法院的訟訴，在台積電提出上訴未果後，法院於二零零八年十月十五日、十月二十九日及十一月二十五日舉行聽證會。二零零九年六月十日法院作出一審判決，一審中法院沒有支援中芯國際對台積電的訴訟請求，中芯國際已就一審判決向中華人民共和國最高人民法院提出上訴。

根據SFAS第144號的規定，本公司須決定該未決訴訟是否屬於需要進一步分析專利特許組合有否減值的事件。本公司認為，該法律訴訟現處於初步階段，故仍在評估訴訟是否屬於該類事件。本公司預期將獲得更多資料以助本公司作出決定。根據SFAS第144號進行的減值分析結果或會嚴重影響本公司財務狀況及經營業績。由於訴訟仍處於初步階段，本公司無法評估不利判決的可能性，亦無法評估可能損失的金額或範圍。

投資者聯絡資料：

En-Ling Feng

電話：+86-21-3861-0000，內線： 16275

Enling_Feng@smics.com

Anne Wong Chen

電話：+86-21-3861-0000，內線： 12804

Anne_CAYW@smics.com

Edith Kwan

電話：+852-2116-2624

Edith_Kwan@smics.com

二零零九年第二季經營業績概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	季度比較	二零零八年 第二季度 ⁽³⁾	年度比較
銷售收入	267,422	146,519	82.5%	342,919	-22.0%
銷售成本	280,319	275,900	1.6%	322,077	-13.0%
毛利(虧損)	(12,897)	(129,381)	-90.0%	20,842	-
經營開支	81,606	46,681	74.8%	60,750	34.3%
經營虧損	(94,503)	(176,062)	-46.3%	(39,908)	136.8%
其他費用，淨額	(5,802)	(4,480)	29.5%	(5,193)	11.7%
所得稅利益（支出）	2,880	3,305	-12.8%	(2,046)	-
稅後淨虧損	(97,425)	(177,238)	-45.0%	(47,147)	106.6%
應佔聯營公司虧損	(482)	(874)	-44.9%	(85)	467.1%
淨虧損	(97,907)	(178,111)	-45.0%	(47,232)	107.3%
非控制權益持有人利息	(262)	(259)	1.1%	1,603	-
普通股持有人應佔虧損	(98,169)	(178,370)	-45.0%	(45,629)	115.1%
毛利率	-4.8%	-88.3%		6.1%	
經營利潤率	-35.3%	-120.2%		-11.6%	
每股普通股股份淨虧損－基本 ⁽¹⁾	(0.00)	(0.01)		(0.00)	
每股美國預托股股份淨虧損－基本	(0.22)	(0.40)		(0.12)	
每股普通股股份淨虧損－攤薄 ⁽¹⁾	(0.00)	(0.01)		(0.00)	
每股美國預托股股份淨虧損－攤薄	(0.22)	(0.40)		(0.12)	
付運晶圓（8吋等值） ⁽²⁾	341,261	168,682	102.3%	402,114	-15.1%
產能使用率	75.4%	34.9%		92.2%	

附注：

(1) 基於二零零九年第二季加權平均普通股 22,352,000,000 股（基本）及 22,352,000,000 股（攤薄），二零零九年第一季 22,344,000,000 股（基本）及 22,344,000,000 股（攤薄），二零零八年第二季 18,589,000,000 股（基本）及 18,589,000,000 股（攤薄）

(2) 包括銅接連件

- 二零零九第二季總銷售額由二零零九年第一季的 146,500,000 元上升至 267,400,000 元，錄得季度升幅 82.5%，是由於晶圓出貨量上升 102.3%所致。

- 二零零九年第二季的銷售成本與二零零九年第一季的 275,900,000 元相比，上升 1.6%至 280,300,000 元。
- 二零零九年第二季的毛利與二零零九年第一季的負 129,400,000 元相比，下降至負 12,900,000 元，二零零八年第二季的毛利為正 20,800,000 元。
- 二零零九年第二季的毛利率由二零零九年第一季的負 88.3%提高至負 4.8%。主要由於出貨量大幅增加和產能使用率大幅上升所致。
- 二零零九年第二季的總經營開支與二零零九年第一季的 46,700,000 元相比，錄得季度升幅 74.8%至 81,600,000 元。
- 二零零九年第二季的研發費用與二零零九年第一季相比，由 18,500,000 元上升 162.0%至 48,500,000 元，主要由於二零零九年第二季政府補助金下降所致。剔除政府補貼，研發費用增加 7,400,000 元錄得季度升幅 18.0%，主要是由於與 45 納米研發活動相關的費用及其他研發費用增加所致。
- 二零零九年第二季的一般行政費用與二零零九年第一季的 14,900,000 元相比，上升至 17,200,000 元，是由於二零零九年第一季與經營活動相關的匯兌收益為 5,900,000 元，剔除匯兌差異，二零零九年第二季的一般行政費用減少 4,700,000 元，錄得季度降幅 22.5%。
- 二零零九年第二季的銷售費用由二零零九年第一季的 4,200,000 元上升至 6,900,000 元，錄得季度升幅 64.1%。

收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	二零零八年 第二季度
電腦	4.3%	4.2%	7.9%
通訊	53.5%	50.9%	51.1%
消費	36.1%	32.9%	32.4%
其他	6.1%	12.0%	8.6%
以服務分類	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	二零零八年 第二季度
邏輯 ⁽¹⁾	90.9%	85.3%	85.7%
記憶	2.7%	2.8%	3.6%
光罩製造，探測及其它	6.4%	11.9%	10.7%
以客戶類別分類	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	二零零八年 第二季度
非廠房半導體公司	65.1%	70.9%	54.6%
集成裝置製造商	18.2%	11.4%	25.7%
系統公司及其它	16.7%	17.7%	19.7%
以地區分類	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	二零零八年 第二季度
北美洲	61.4%	60.4%	55.1%
大中國 ⁽²⁾	33.2%	32.3%	31.4%
亞洲 ⁽³⁾	3.9%	5.2%	6.9%
歐洲	1.5%	2.1%	6.6%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比（僅包括邏輯、記憶及銅接連件）	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	二零零八年 第二季度
65 納米	0.1%	0.1%	0.0%
90 納米	16.6%	8.1%	18.4%
0.13 微米	29.7%	30.8%	22.9%
0.15 微米	1.5%	0.8%	2.1%
0.18 微米	29.8%	31.5%	37.7%
0.25 微米	0.5%	0.4%	0.6%
0.35 微米	21.8%	28.3%	18.3%

附注：

- (1) 包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 包括香港和臺灣
- (3) 不包括大中國區

產能*

廠／（晶圓尺寸）	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度
上海廠（8吋）	88,000	85,000
北京廠（12吋）	40,500	33,750
天津廠（8吋）	34,300	32,000
每月晶圓裝配總產能	162,800	150,750

附注：

(1) *期終每月晶圓計 8 吋等值

- 本季晶圓產能增加是由於整體生產效率改善所致

付運及使用率：

8 吋等值晶圓	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	二零零八年 第二季度
付運晶圓（包括銅接連件）	341,261	168,682	402,114
使用率 ⁽¹⁾	75.4%	34.9%	92.2%

附注：

(1) 產能使用率按輸出品圓總額除以估計產能計算

- 二零零九年第二季晶圓付運數量較二零零九年第一季的 168,682 片 8 吋等值晶圓增加 102.3%至 341,261 片 8 吋等值晶圓，較二零零八年第二季度的 402,114 片 8 吋等值晶圓錄得年度降幅 15.1%。

2. 詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	季度比較	二零零八年 第二季度	年度比較
銷售成本	280,319	275,900	1.6%	322,077	-13.0%
折舊	146,763	158,000	-7.1%	153,783	-4.6%
其他製造成本	126,655	111,166	13.9%	160,938	-21.3%
遞延成本攤銷	5,886	5,886	0.0%	5,886	0.0%
股權報酬	1,015	848	19.7%	1,470	-31.0%
毛利（虧損）	(12,896)	(129,381)	-90.0%	20,842	-
毛利率	-4.8%	-88.3%		6.1%	

- 二零零九年第二季的銷售成本與二零零九年第一季的 275,900,000 元相比，上升 1.6% 至 280,300,000 元。
- 二零零九年第二季的毛利與二零零九年第一季的負 129,400,000 元相比，下降至負 12,900,000 元，二零零八年第二季的毛利為正 20,800,000 元。
- 二零零九年第二季的毛利率由二零零九年第一季的負 88.3% 提高至負 4.8%。主要由於出貨量大幅增加和產能使用率大幅上升所致。

經營開支分析

以千美元計	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	季度比較	二零零八年 第二季度	年度比較
總經營開支	81,606	46,681	74.8%	60,750	34.3%
研究及開發	48,450	18,494	162.0%	37,684	28.6%
一般及行政	17,196	14,928	15.2%	13,328	29.0%
銷售及市場推廣	6,905	4,208	64.1%	4,356	58.5%
無形資產攤銷	8,858	9,031	-1.9%	6,898	28.4%
資產處置損失（收入）	197	20	861.7%	(1,517)	-

- 二零零九年第二季的總經營開支與二零零九年第一季的 46,700,000 元相比，錄得季度升幅 74.8% 至 81,600,000 元。
- 二零零九年第二季的研發費用與二零零九年第一季相比，由 18,500,000 元上升 162.0% 至 48,500,000 元，主要由於二零零九年第二季政府補助金下降所致。剔除政府補貼，研發費用增加 7,400,000 元錄得季度升幅 18.0%，主要是由於與 45 納米研發活動相關的費用及其他研發活動費用增加所致。
- 二零零九年第二季的一般行政費用與二零零九年第一季的 14,900,000 元相比，上升至 17,200,000 元，是由於二零零九年第一季與經營活動相關的匯兌收益為 5,900,000 元，

剔除匯兌差異，二零零九年第二季的一般行政費用減少 4,700,000 元，錄得季度降幅 22.5%。

- 二零零九年第二季的銷售費用由二零零九年第一季的 4,200,000 元上升至 6,900,000 元，錄得季度升幅 64.1%。

其他收入（支出）

以千美元計	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度	季度比較	二零零八年 第二季度	年度比較
其他收入（支出）	(5,802)	(4,480)	29.5%	(5,193)	11.7%
利息收入	635	436	45.5%	4,059	-84.4%
利息支出	(8,386)	(5,498)	52.5%	(15,279)	-45.1%
匯兌收益（虧損）	219	(357)	-	2,478	-91.2%
其他，淨額	1,730	939	84.2%	3,549	-51.3%

- 二零零九年第二季的利息費用增加是由於本季政府利息補貼減少所致。
- 合併來自於經營性活動的匯兌損益，公司於二零零九年第二季整體錄得匯兌虧損 800,000 元，二零零九年第一季錄得匯兌收益 5,500,000 元。

折舊及攤銷

- 二零零九年第二季的折舊及攤銷總額為 202,900,000 元，相較於二零零九年第一季的 207,800,000 元。

流動資金

以千美元計	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度
現金及現金等價物	435,613	502,016
限制性現金	22,580	11,228
短期投資	3,313	20,732
應收賬款	236,413	156,177
存貨	183,012	154,783
其他	74,717	78,728
流動資產總計	955,648	923,664
應付賬款	166,699	135,352
短期借款	273,678	270,078
長期借款的即期部份	205,344	359,080
其他	147,726	144,146
流動負債總計	793,447	908,656
現金比率	0.5x	0.5x
速動比率	0.8x	0.7x
流動比率	1.2x	1.0x

資本結構

以千美元計	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度
現金及現金等價物	435,613	502,016
限制性現金	22,580	11,228
短期投資	3,313	20,732
長期票據即期部分	29,242	29,493
長期票據	9,500	23,792
短期借款	273,678	270,078
長期借款的即期部份	205,344	359,080
長期借款	615,999	533,090
總借款	1,095,021	1,162,248
股東權益	2,478,322	2,573,891
總債務股本比率	44.2%	45.2%

- 在我們合作銀行的大力支持下，公司已經成功對北京分公司剩餘的3億美元長期貸款進行重組，將此貸款延期2年半。

現金流量概要

以千美元計	二零零九年 第二季度	二零零九年 第一季度
來自於經營活動的現金淨額	43,198	78,117
來自於投資活動的現金淨額	(27,353)	(81,785)
來自於融資活動的現金淨額	(82,191)	54,846
現金變動淨額	(66,403)	51,786

資本開支概要

- 二零零九年第二季資本開支為21,000,000元，截至二零零九年六月三十日止六個月的總資本支出為44,900,000元。
- 二零零九年預期的資本開支總額將約為190,000,000元，並將根據市場狀況作調整。

近期公佈

- 中芯國際 45 納米高性能工藝獲得良率驗證（二零零九年六月三十日）
- 中芯國際調高二零零九年第二季度營收指引（二零零九年六月二十九日）
- 中芯國際和新思科技攜手推出 Reference Flow 4.0（二零零九年六月二十四日）
- 董事變更及主席變更（二零零九年六月二十三日）
- 2009 年 6 月 23 日舉行之股東周年常會投票表決結果（二零零九年六月二十三日）
- 年終報告根據 1934 年證券交易規則第 13 部分或 15(d) 部分公佈（二零零九年六月二十二日）
- 中芯國際將在 45 納米物理 IP 及標準單元的開發中部署新思科技的 HSPICE 模擬器（二零零九年六月四日）
- 暫停辦理股份過戶登記（二零零九年六月三日）
- 中芯國際發佈 65 納米低漏電工藝的 IP 產品（二零零九年五月十五日）
- 授出購股期權（二零零九年五月十一日）
- 中芯截止二零零九年三月三十一日止三個月業績公佈（二零零九年四月二十九日）
- 股東周年大會通告（二零零九年四月二十七日）
- 二零零八年年度業績公佈（二零零九年四月二十七日）
- 中芯國際通函（二零零九年四月二十七日）
- 與大唐控股的不獲豁免的持續關連交易（二零零九年四月十七日）
- 二零零八年年度業績公佈（二零零九年四月十七日）
- 中芯國際和 DOLPHIN 公司宣佈合作推出攜帶型媒體播放器（二零零九年四月十七日）
- 董事會會議日期通知（二零零九年四月十六日）
- 董事會通過刊發年度業績報告日期通知（二零零九年四月三日）

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

http://www.smics.com/website/cnVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

合併資產負債表
(美元)

截至以下日期止

	二零零九年 六月三十日 (未經審核)	二零零九年 三月三十一日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	435,613,297	502,015,857
限定用途的現金	22,579,630	11,227,741
短期投資	3,312,592	20,731,562
應收賬款，已扣除撥備分別為 二零零九年六月三十日 5,637,336 元 及二零零九年三月三十一日 5,870,986 元	236,412,588	156,177,160
存貨	183,011,768	154,783,494
預付款項及其它流動資產	53,276,615	57,287,558
製造機台銷售應收款	21,440,494	21,440,494
流動資產合計	955,646,984	923,663,866
預付土地使用權	78,860,359	79,234,650
廠房及設備，淨額	2,625,371,271	2,792,875,058
購入無形資產，淨額	184,845,479	191,028,492
遞延成本，淨額	35,318,637	41,205,077
股權投資	10,275,172	10,756,777
其他長期預付款	825,389	1,486,807
遞延稅資產	57,250,700	51,969,380
資產合計	3,948,393,991	4,092,220,107
負債及股東權益		

流動負債：

應付帳款	166,698,508	135,351,888
預提費用及其它流動負債	117,632,973	114,185,387
短期借款	273,678,075	270,078,251
長期票據的即期部份	29,242,001	29,492,873
長期借款的即期部份	205,343,559	359,079,883
應付所得稅	851,539	467,869
流動負債合計	793,446,655	908,656,151

長期負債：

長期票據	9,500,358	23,792,341
長期借款	615,998,747	533,090,173
與特許權協定相關的長期應付款	16,488,420	18,375,736
遞延稅負債	335,577	373,727
長期負債合計	642,323,102	575,631,977

負債合計 **1,435,769,757** **1,484,288,128**

非控制權益 34,302,529 34,040,748

承諾

股東權益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，
於二零零九年六月三十日及二零零九年三月三十一日法定及已發行股份分別為 22,353,411,672 股及 22,350,521,609 股。

8,941,365 8,940,209

額外繳入股本 3,494,327,734 3,491,661,468

累計其他綜合（虧損）收入	98,945	169,290
累計虧絀	(1,025,046,339)	(926,879,736)
所有股東權益合計	2,478,321,705	2,573,891,231
總負債及股東權益合計	3,948,393,991	4,092,220,107

合併營運報表
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零九年 六月三十日 (未經審核)	二零零九年 三月三十一日 (未經審核)
銷售額	267,422,419	146,518,884
銷售成本	280,318,656	275,899,824
毛利	(12,896,237)	(129,380,940)
經營費用：		
研究和開發	48,450,248	18,494,784
一般及行政	17,195,574	14,927,735
銷售和市場推廣	6,904,892	4,207,593
購入無形資產攤銷	8,858,012	9,030,614
來自廠房設備和其他固定資產的銷售 損失	196,980	20,484
經營費用總額	81,605,706	46,681,210
經營虧損	(94,501,943)	(176,062,150)
其他收入(支出)：		
利息收入	634,737	436,294
利息支出	(8,386,025)	(5,498,154)
匯兌收益(虧損)	219,319	(357,034)
其他,淨額	1,730,404	938,969
其他支出,淨額	(5,801,565)	(4,479,925)
所得稅前虧損	(100,303,508)	(180,542,075)

所得稅利益	2, 880, 291	3, 304, 513
股權投資虧損	(481, 605)	(873, 513)
淨虧損	(97, 904, 822)	(178, 111, 075)
非控制權益持有人利息	(261, 781)	(258, 904)
普通股持有人應佔虧損	(98, 166, 603)	(178, 369, 979)
每股股份淨虧損，基本	(0. 0044)	(0. 0080)
每股美國預托股份淨虧損，基本	(0. 2196)	(0. 3992)
每股股份淨虧損，攤薄	(0. 0044)	(0. 0080)
每股美國預托股份淨虧損，攤薄	(0. 2196)	(0. 3992)
用作計算基本每股普通股 虧損額的股份	22, 352, 477, 317	22, 343, 640, 476
用作計算攤薄每股普通股 虧損額的股份	22, 352, 477, 317	22, 343, 640, 476

合併現金流量表
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零九年 六月三十日 (未經審核)	二零零九年 三月三十一日 (未經審核)
經營活動：		
淨虧損	(97,904,822)	(178,111,075)
淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整：		
遞延稅	(5,319,471)	(6,321,059)
處置設備及其它長期資產損失	196,980	20,484
折舊及攤銷	191,368,626	196,535,950
長期票據及與特許權協定相關的長期應付款的非現金利息費用	992,974	1,046,426
購入無形資產攤銷	8,858,012	9,030,614
股權報酬	2,630,178	2,272,359
股權投資虧損	481,605	873,513
營運資產及負債的變動：		
應收賬款，淨額	(80,235,429)	43,194,535
存貨	(28,228,273)	16,853,373
預付款及其它流動資產	4,672,361	(579,942)
應付賬款	39,046,117	(6,456,221)
預提費用及其它流動負債	6,255,592	(158,281)
應付所得稅	383,671	(84,138)
經營活動所得現金淨額	43,198,121	78,116,538

投資活動：

購入廠房、設備	(44,759,433)	(72,018,394)
政府授予購買廠房及設備所得款項	14,544,928	6,437,831
出售設備所得款項	(191,827)	1,700,577
出售待售資產所得款項	(26,201)	770,931
購買所獲無形資產	(2,987,788)	(12,621,260)
購買短期投資	(5,648,618)	(31,496,963)
出售短期投資	23,067,587	30,693,690
轉換限定用途的現金	(11,351,889)	(4,972,928)
購買股權投資	–	(278,103)
投資活動所耗現金淨額	(27,353,241)	(81,784,619)

融資活動：

短期借款所得款項	215,404,493	182,644,921
償還短期借款支付的款項	(211,804,669)	(113,824,443)
償還長期借款支付的款項	(70,827,750)	(4,977,014)
償還票據支付的款項	(15,000,000)	–
行使雇員購股權所得款項	37,245	15,937
償還非控制股權支付的款項	–	(9,013,444)
融資活動所得(所耗)現金淨額	(82,190,681)	54,845,957
匯率變動的影響	(56,759)	608,412

現金及現金等價物增加(減少)淨額	(66,402,560)	51,786,288
現金及現金等價物－期間開始	502,015,857	450,229,569
現金及現金等價物－期間結束	435,613,297	502,015,857

於本公告日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事江上舟先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事張汝京先生、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周杰先生（及周杰先生的替任董事汪正綱先生），以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生及楊雄哲先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官
張汝京

中國上海

二零零九年七月二十八日

* 僅供識別